

Oberflächen bei G&W

Oberfläche	Schichtstärke	Bonden	Lötbarkeit
ENIG (ch. Ni/Au)	4 – 7µm Ni/ 0,05 – 0,1µm Au	Al	1 Jahr
ENEPIG (ch. Ni/Pd/Au)	Ni: 4 – 8µm / Pd: 0,1- 0,3µm / Au: 0,03-0,08µm	Al / Au	1 Jahr
ISIG (ch. Ag /ch. Au)	0,1 – 0,4µm Ag 0,1 – 0,2µm Au	Al / Au	
HAL bleifrei	bedeckt im Schulterbereich – 40µm		1 Jahr
HAL verbleit	Bedeckt im Schulterbereich- 40µm		1 Jahr
ch. Sn	0,8 – 1,2µm		6 Monate
Galv. Au (Hartgold / Bondgold)	5µm Ni / 0,2 – 3µm Au	Al / Au	1 Jahr
ch. Pd/Au	0,1-0,2µm Pd / 0,1-0,2µm Au	Al / Au	1 Jahr
ch. Silber	0,15 – 0,45 µm Ag		6 Monate

weitere Oberflächen OSP / EPIG (ch. Pd/Teilreduktivgold) auf Anfrage